

描述 / Descriptions

TO-92 塑封封装 NPN 半导体三极管。Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package.

特征 / Features

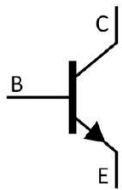
击穿电压高,可与 2N5401 互补。

High voltage, complementary Pair with 2N5401.

用途 / Applications

用于普通高压放大。

General purpose high voltage amplifier.

内部等效电路 / Equivalent Circuit**引脚排列 / Pinning**

PIN 1 : Collector PIN 2 : Base PIN 3 : Emitter

放大及印章代码 / h_{FE} Classifications & Marking

h_{FE} Classifications Symbol	A	B	C
h_{FE} Range	50~150	100~300	200~400

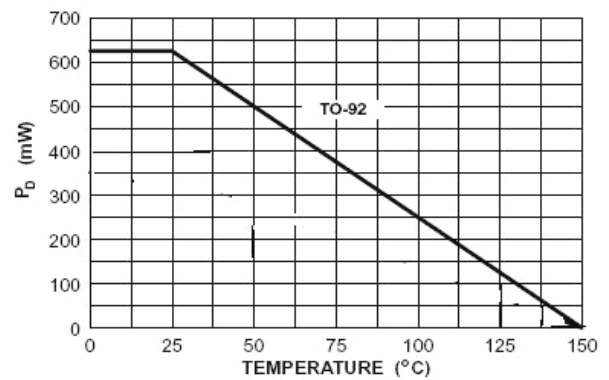
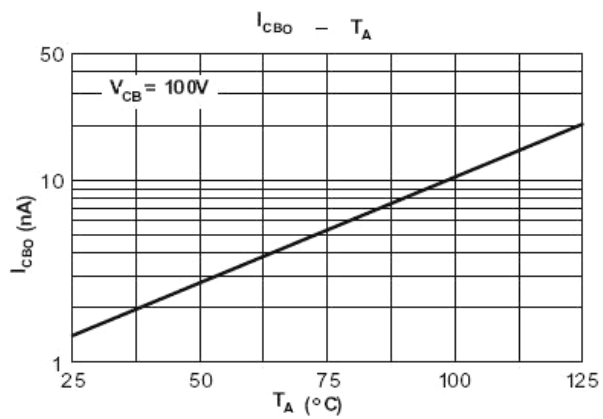
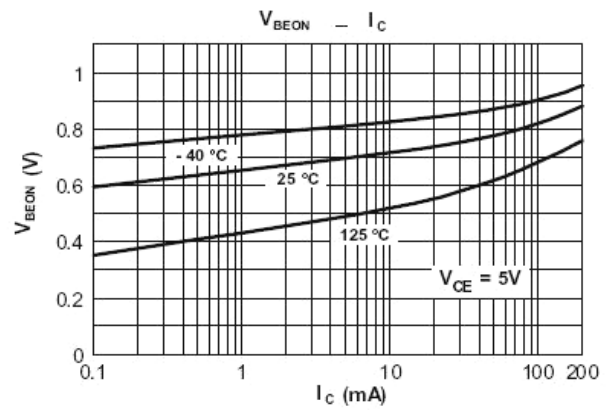
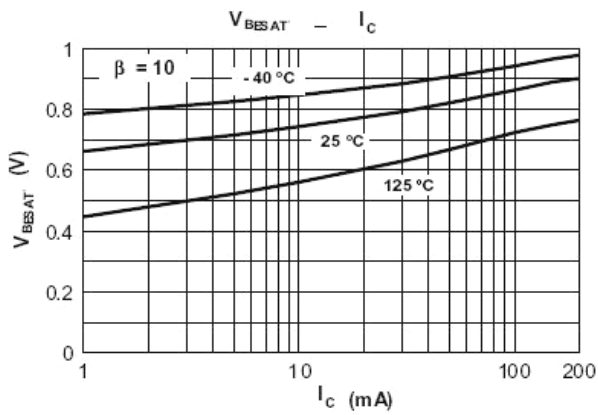
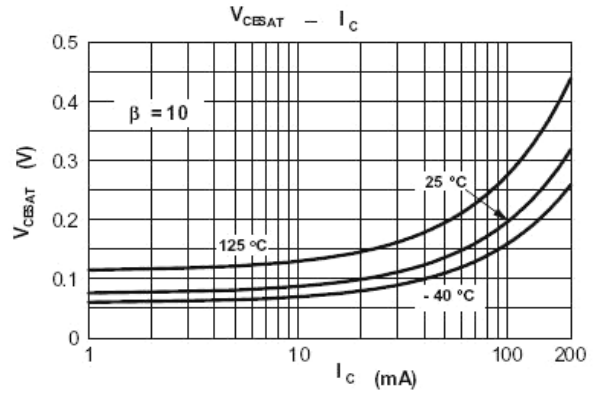
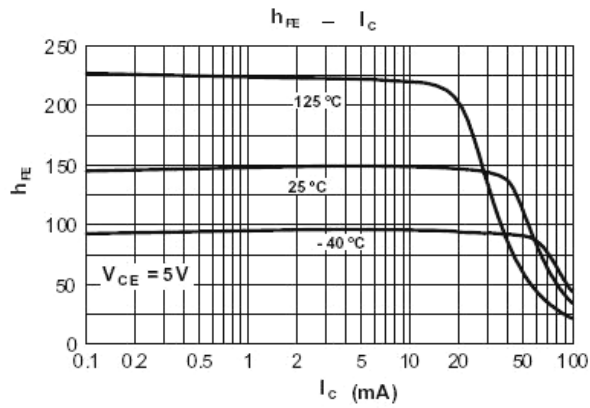
极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	180	V
Collector to Emitter Voltage	V_{CEO}	160	V
Emitter to Base Voltage	V_{EBO}	6.0	V
Collector Current - Continuous	I_C	600	mA
Base Current - Continuous	I_B	300	mA
Collector Power Dissipation	P_C	625	mW
Junction Temperature	T_j	150	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55~150	°C

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}	$V_{CB}=180V$ $I_E=0$			0.1	μA
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}	$V_{EB}=6.0V$ $I_C=0$			0.1	μA
DC Current Gain	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=10mA$	50	200	400	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=50mA$	20	160		
	$h_{FE(3)}$	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=1.0mA$	40	190		
Collector to Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)(1)}$	$I_C=10mA$ $I_B=1.0mA$		0.06	0.15	V
	$V_{CE(sat)(2)}$	$I_C=50mA$ $I_B=5.0mA$		0.09	0.3	V
Base to Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)(1)}$	$I_C=10mA$ $I_B=1.0mA$		0.7	1.0	V
	$V_{BE(sat)(2)}$	$I_C=50mA$ $I_B=5.0mA$		0.8	1.0	V
Base to Emitter Voltage	V_{BE}	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=10mA$		0.68	0.75	V
Current Gain Bandwidth Product	f_T	$V_{CE}=10V$ $I_C=10mA$	50	110		MHz
Output Capacitance	C_{ob}	$V_{CB}=10V$ $I_E=0$ $f=1.0MHz$		2.2	5.0	pF
Turn On Time	t_{on}	$I_C=100mA$ $I_{B1}=-I_{B2}=10mA$		0.3		μs
Turn Off Time	t_{off}	$I_C=100mA$ $I_{B1}=-I_{B2}=10mA$		0.4		μs
Storage Time	t_{stg}	$I_C=100mA$ $I_{B1}=-I_{B2}=10mA$		0.2		μs

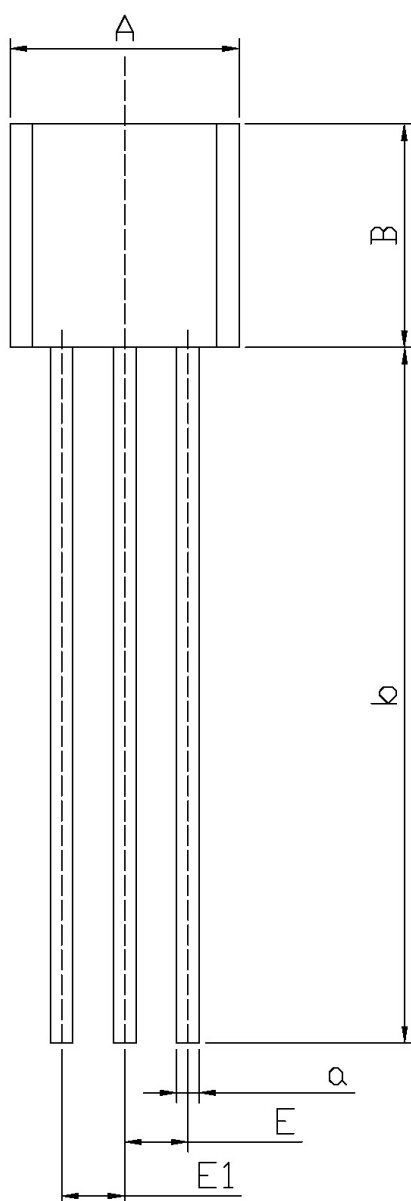
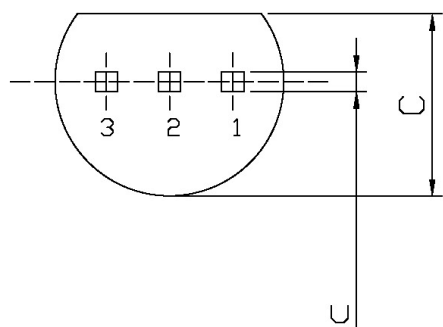
电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve



外形尺寸图 / Package Dimensions

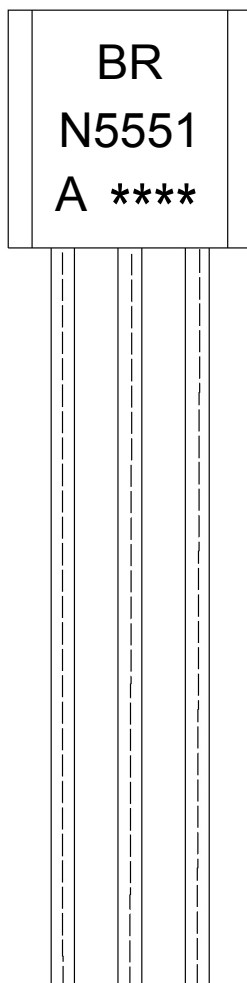
TO-92

Unit: mm



Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max
A	4.4	4.8
B	4.3	4.7
b	13	15
a	0.40	0.60
E	1.22	1.32
E1	1.22	1.32
C	3.4	3.8
c	0.30	0.50

印章说明 / Marking Instructions



说明：

BR： 为公司代码

N5551： 为型号代码

A： 为 h_{FE} 分档代码

****： 为生产批号代码，随生产批号变化。

Note:

BR: Company Code.

N5551: Product Type Code.

A: h_{FE} Classifications Symbol.

****: Lot No. Code, code change with Lot No.

波峰焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)



说明：

1. 预热温度 25 ~ 150°C，时间 60 ~ 90sec;
2. 峰值温度 255±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
3. 焊接制程冷却速度为 2 ~ 10°C/sec.

Note:

1. Preheating: 25~150°C, Time: 60~90sec.
2. Peak Temp.: 255±5°C, Duration: 5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：270±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.: 270±5°C

Time: 10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

散件包装 / BULK

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm3)		
	Units/Bag 只/袋	Bags/Inner Box 袋/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Bag 袋	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-92	1,000	10	10,000	5	50,000	135×190	237×172×102	560×245×195
	1,000	10	10,000	10	100,000	135×190	237×172×102	560×245×375

编带包装 / AMMO

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm3)	
	Units/tape 只/纸带	Tape/Inner Box 纸带/盒	Rows/Inner Box 纸带层/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-92	3,000	1	120	10	30,000	328×230×42	小箱 480×346×235, 大箱 547×407×268

使用说明 / Notices